



# SPE-2136A

プラズマクリーナー  
Plasma Cleaner

## デスカム・表面改質・アッシング処理

Descum / Surface Modification / Ashing Treatment

## φ6インチウェハー2枚同時処理の ハイタクトモデル

High-tact model for simultaneous processing  
of two 6-inch wafers

### 【概要】

本装置はφ4～φ6インチウェハーに対しデスカム・表面改質・アッシング処理が可能です。また、自動搬送機構を付属しておりウェハー割れ防止や、ウェハー移載にかかる作業時間コストの削減に貢献します。さらに、プロセス室はウェハー2枚同時処理により高いスループットを実現しています。

装置本体サイズがW1,400mm×D2,000mmとコンパクトな設計となっています。

### 【General Outline】

This equipment can descum, modificate the surface, and ash on φ4 to φ6 inch wafers. In addition, it comes with an automatic transfer mechanism, which contributes to preventing wafer cracking and reducing the work time cost required for wafer transfer. Furthermore, the process room achieves high throughput by processing two wafers at the same time.

The equipment body size is W1,400 mm x D2,000 mm, which is a compact design.



### 【特長・オプション等】

1. C to C
2. 高スループット
3. 分布：ウェハー内±10%以下 (Si基板)
4. 2枚同時処理、低温処理
5. Arプラズマクリーニング (オプション)
6. イオナイザーによる静電対策 (オプション)

### 【Features/Options】

- 1.C to C
- 2.High throughput
- 3.Distribution: ± 10% or less in the wafer (Si substrate)
- 4.Simultaneous processing of 2 sheets, low temperature processing
- 5.Ar plasma cleaning (optional)
- 6.Anti-static measures by ionizer (optional)

### 【用途・応用例】

各種ウェハー電子部品のレジスト除去  
後工程メッキ前の表面改質  
有機汚染除去  
樹脂材料の表面改質  
SAWデバイスなどの極薄圧電ウェハー対応

### 【Applications】

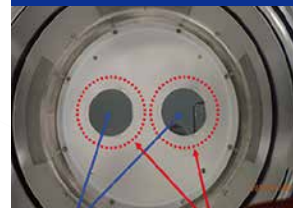
Resist removal of various wafer electronic components  
Surface modification before post-process plating  
Organic pollutant removal  
Surface modification of resin material  
For ultra-thin piezoelectric wafers such as SAW equipments

## デスカム・表面改質・アッシング処理

Descum / Surface Modification / Ashing Treatment

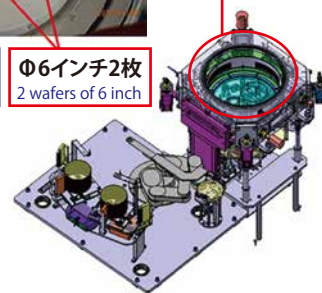
仕 様 Specifications	
装置構成 Equipment Configuration	(1) 搬送ロボットを搭載した搬送エリアとアッシング室で構成 (1) Consists of a transport area equipped with a transport robot and an ashing room  (2) 真空槽材質は、脱脂処理を施したA5052製を採用 (2) The vacuum tank material is made of A5052 that has been degreased.
排気系 Pumping System	ドライポンプ 1式 1 set of dry pump
性 能 Performance	(1) 到達圧力: 1Pa以下 (1) Reaching Pressure: 1Pa or less  (2) 排気時間: 10Paまで18秒以内 (2) Pumping Time: Within 18 seconds up to 10Pa  (3) アッシング分布: ±10%以内 (3) Ashing Distribution: Within ± 10%  (4) サイクルタイム: 45sec (18枚/カセット、φ4インチ基板) ※参考値 (4) Tact Time: 45sec (18 sheets/cassette, φ4 inch substrate) * Reference value
電源系 Power Supply System	(1) RF電源: MAX 1,000W (13.56MHz) (1) RF Power: MAX 1,000W (13.56MHz)  (2) マッチングボックス: オートマッチング仕様 (2) Matching Box: Auto matching specifications
ガス導入系 Gas Introduction System	O <sub>2</sub> ガス用 マスフローコントローラー 1式 1 set of mass flow controller for O <sub>2</sub> gas
制御系 Control System	(1) シーケンサーの使用により、全自動操作が可能 (1) Fully automatic operation is possible by using a sequencer  (2) 基板処理枚数はタッチパネル上に常時表示し、エラー履歴を確認可能 (2) The number of substrates processed is always displayed on the touch panel, and the error history can be checked.  (3) レシピ管理、ログ取得を付属のパソコンにて行います (3) Recipes management and log acquisition are performed on the attached personal computer.
外形寸法 External Dimensions	装置本体: W1,340mm×D1,945mm×H1,870mm Equipment Body: W1,340mm×D1,945mm×H1,870mm  装置重量: 1,000Kg Equipment Weight: 1,000Kg
ユーティリティー Utility	(1) 電力: 200V 3φ 50/60Hz 14.3KVA (1) Electric Power: 200V 3φ 50/60Hz 14.3KVA  (2) 冷却水: 20~25℃ 0.36m <sup>3</sup> /hr (6ℓ/min) (2) Cooling Water: 20~25℃ 0.36m <sup>3</sup> /hr (6ℓ/min)  (3) 圧空: 0.5MPa 20ℓ/min (3) Compressed Air: 0.5MPa 20ℓ/min  (4) O <sub>2</sub> ガス: 0.05MPa プロセス用 (4) O <sub>2</sub> gas: 0.05MPa For process  (5) N <sub>2</sub> ガス: 0.3MPa 60ℓ/min (5) N <sub>2</sub> gas: 0.3MPa 60ℓ/min  (6) アース: A種アース (6) Earth: Class A earth

### 処理室内 In processing room



φ4インチ2枚  
2 wafers of 4 inch

φ6インチ2枚  
2 wafers of 6 inch



### φ4、φ6インチウェハー2枚同時処理対応

Supports simultaneous processing of two φ4 and φ6 inch wafers



株式会社 昭和真空  
SHOWA SHINKU CO., LTD.

ご質問・詳細につきましては、  
営業部までお気軽にお問合せください。

お問合せ先【営業部】

本社・相模原工場  
〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3062-10

**TEL. 042-764-0370**

FAX. 042-764-0377

E-mail. sales-pamphlet@showashinku.co.jp

<https://www.showashinku.co.jp/>

昭和真空

検索

### Inquiry [Sales Dep.]

HQ and Sagami-hara Plant

3062-10 Tana, Chuo-ku, Sagami-hara-city, Kanagawa 252-0244 Japan

TEL:+81-42-764-0370 FAX:+81-42-764-0377

本製品は、外国為替並びに外国貿易管理法の規定により、戦略物資等輸出規制品に該当する場合があります。従って、日本国外に該当品を持ち出す際は、日本国政府への輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。

This product may be applicable to export control products such as strategic raw materials which are regulated by the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. Accordingly when you bring out the applicable products outside Japan, you should take a necessary action such as application of an export permit to the Government of Japan.

### Web site 製品情報ページ

真空中で特定の基板に薄膜を形成させる装置を主とした、真空蒸着装置やスパッタリング装置等の真空技術応用装置(真空装置)を製造販売しております。



<https://www.showashinku.co.jp/product/>

※本仕様・外観については、改良のため予告なく変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

\* For the improvement of the product, please understand in advance that the specifications and external views are subject to change without prior notice.